



深圳市信维通信股份有限公司
Shenzhen Sunway Communication Co., Ltd

企业使命：致力于通过对**基础材料**，**基础技术**的研究，
创造出值得信赖的创新产品与解决方案，为我们的客户创造价值。



信维通信

信维通信机密信息
Sunway Confidential



致力于通过对**基础材料**、**基础技术**的研究，
创造出值得信赖的创新产品与解决方案，
为我们的客户创造价值。





成立时间：2006年4月27日

总 部：中国·深圳

上市时间：2010年11月

股票代码：300136.SZ

全球人数：10,000+

申请专利：4,138项 (截至2023年底) *



*根据法国研究机构Yole的数据，信维在“中国授予的5G天线专利”数量中排名第一。



2006.04.27
在深圳成立

2006-2010
成立到上市



2010.11.05
深交所创业板上市



2012.11
收购全球最大的
移动终端天线供应商
莱尔德(北京)分公司

2011-2014
大客户平台搭建

产品线扩展

- 射频模组
- 电阻电容
- 基础材料
- 汽车电子
- MIM/CIM
- 精密连接器
- 声学
- 天线
- 无线充电

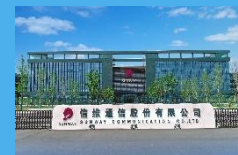
2014之后
坚持技术创新



湖南
益阳产业园



日本
筑波研究院



江苏
常州工业园



美国
圣地亚哥研究院

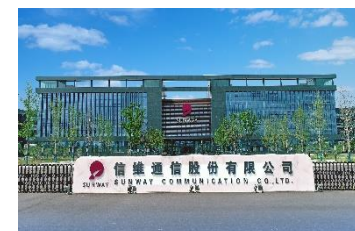
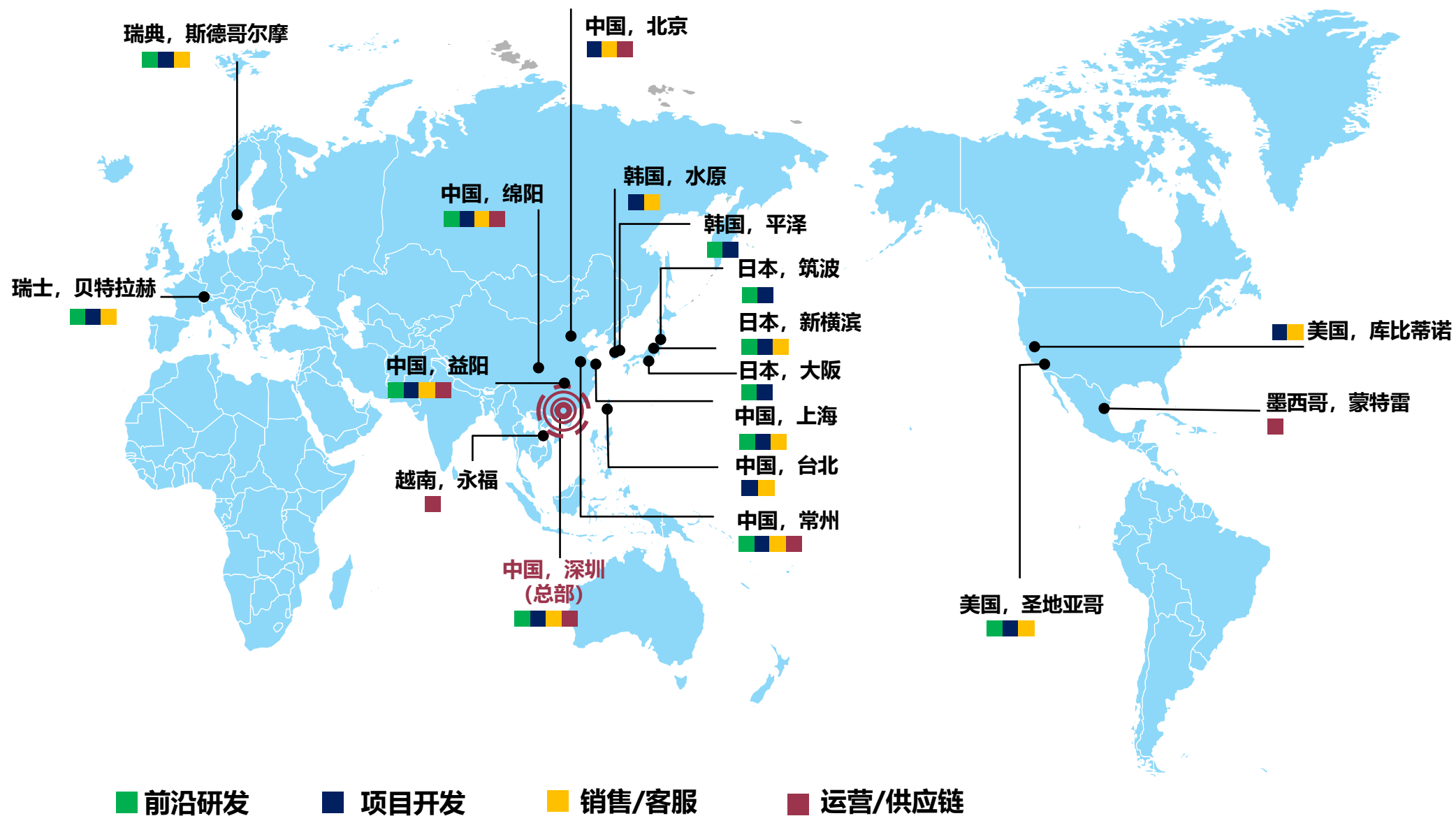


越南
生产基地



墨西哥
生产基地

... ..
全球化布局





广东深圳（总部）

占地面积

280,000 m²



● 目前厂区占地面积(四座工厂): 220,000 m²



● 新桥产业园占地面积(自建, 预计2026年投产) : 59,400 m², 建筑面积25.24万m²

江苏常州

占地面积

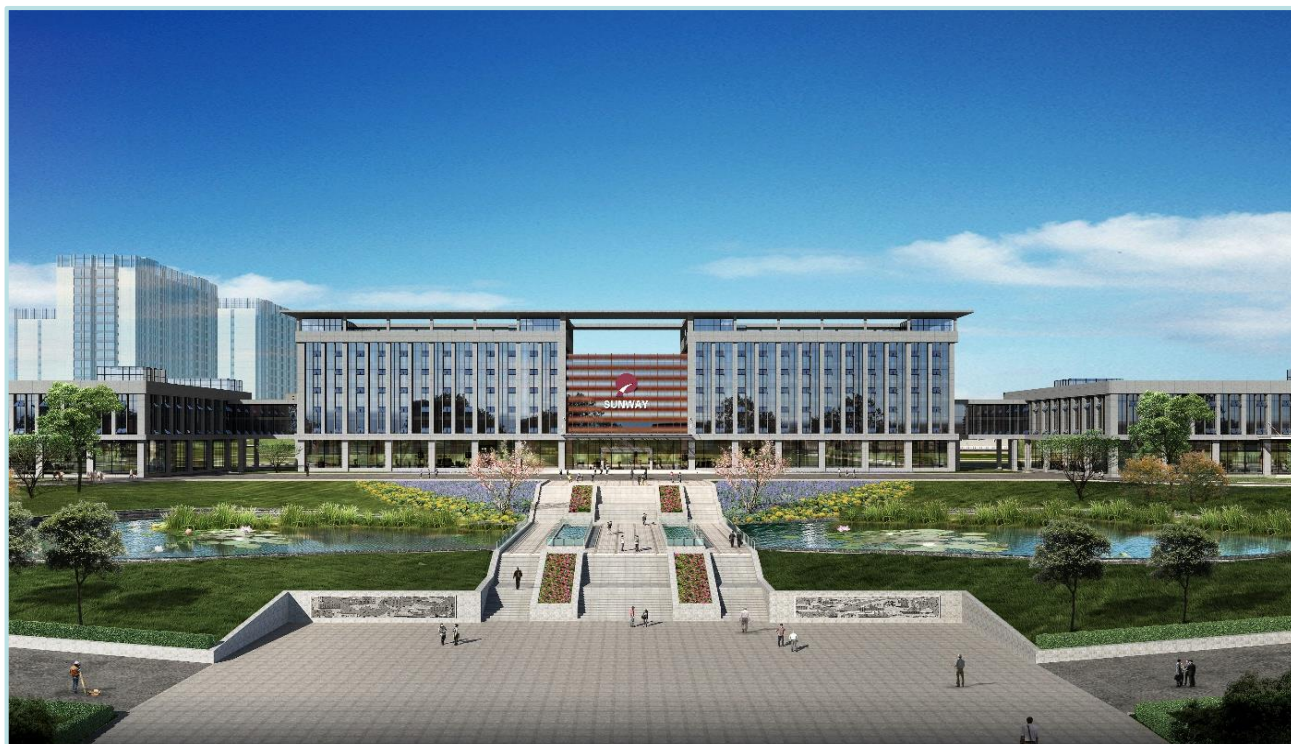
733,333 m²



- 2019年10月份正式投产（自建，占地面积 1100亩，建筑面积96万m²）

湖南益阳

占地面积 778,667 m²



- 2023年10月份正式投产（占地面积1168亩，建筑面积135万m²）



越南永福

占地面积

26,307 m²



- 永福一期:占地面积 9,422m², 建筑面积 5,640m², 2019年6月投产



- 永福二期: 占地面积 16,885m², 建筑面积 30,030m², 2024年Q2投产



墨西哥蒙特雷

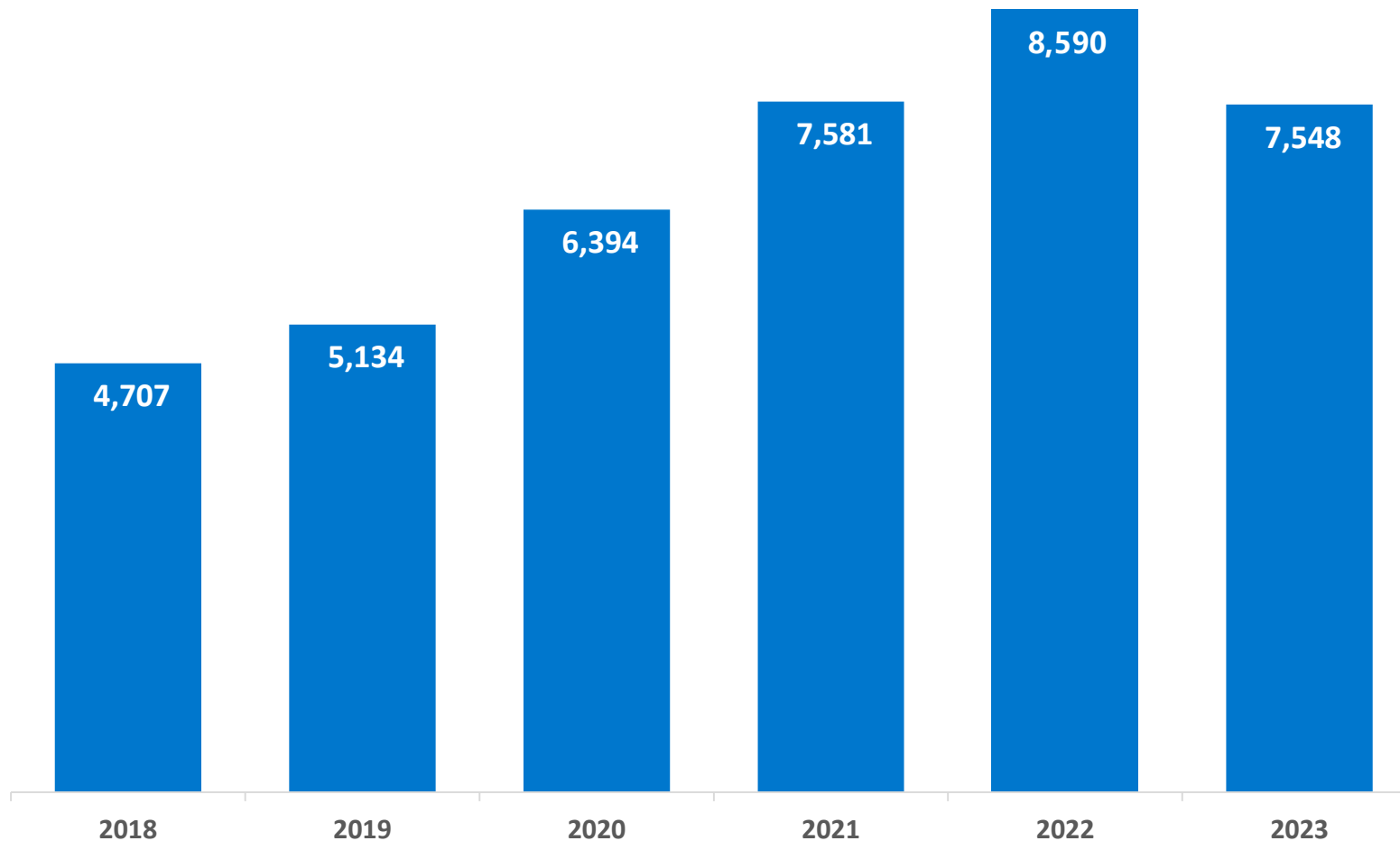
占地面积

4,000 m²



- 一期:占地面积4,000m², 预计2024年Q3投产

信维通信营业收入趋势 2018-2023 (百万人民币)



CAGR 10%
销售额复合增长率

消费电子 Consumer Electronics

应用:



汽车类 Automotive

应用:



通讯/企业类 Communication/Enterprise

应用:



物联网/智能家居类 IoT/Smart home

应用:



业务布局

业务布局

在夯实**消费电子**业务的基础上，积极开拓**汽车、通讯/企业类、物联网及智能家居**业务，平衡集团业务发展。



信维通信通过持续提升创新能力为客户提供一站式零件及模组解决方案

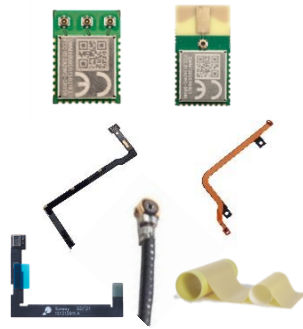
天线

- ▶ **按功能分类**
 - 蜂窝天线
 - Wi-Fi/BT天线
 - GPS天线
 - NFC天线
 - UWB天线
 - 5G天线模组
- ▶ **按工艺分类**
 - LDS 天线
 - LAP 天线
 - PCB天线
 - 金属片天线
 - 机构整合天线
 - 印刷天线
 - 陶瓷天线
 - 透明天线
 - LCP天线模组



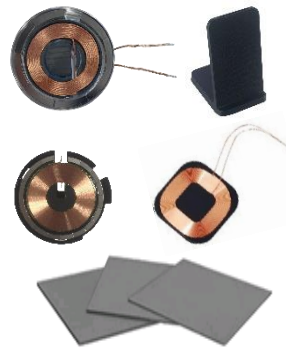
射频传输线/模组

- ▶ **LCP 射频传输线**
 - 5G Sub 6
 - 5G毫米波
- ▶ **射频同轴线缆**
 - \varnothing 0.49 mm
 - \varnothing 0.64 mm
 - \varnothing 0.81 mm
 - \varnothing 1.13 mm
 - \varnothing 1.37 mm
- ▶ **射频连接模组**
 - UWB (恩智浦芯片)
 - 毫米波模组



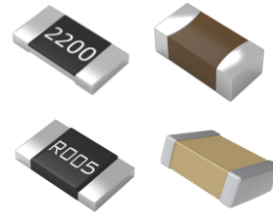
无线充电

- ▶ **接收端模组**
- ▶ **发射端模组/成品**
- ▶ **NFC / Qi Rx Combo**
- ▶ **磁性材料**
 - 软磁材料
 - ✓ 铁氧体
 - ✓ 纳米晶
 - ✓ 非晶
 - 永磁材料
 - ✓ 钕铁硼



无源器件

- ▶ **贴片电阻**
 - 通用厚膜系列
 - 车规系列
 - 抗硫化系列
 - 抗浪涌系列
 - 耐高压系列
 - 耐高温系列
 - 合金系列
- ▶ **贴片陶瓷电容**
 - 通用系列
 - 高容系列
 - 车规系列
 - 高频系列
 - 高压系列
 - 软端子系列
 - 三端子系列



线缆&连接器

- ▶ **板对板连接器**
 - 0.35 pitch BTB
 - 15A Battery BTB
 - RF BTB
- ▶ **接触类弹片**
- ▶ **I/O连接器**
- ▶ **定制化连接器**
- ▶ **汽车连接器**
 - Fakra
 - HSD
 - H-MTD
 - 排针/排母
- ▶ **线缆**
 - 消费类
 - 汽车类
 - 卫星通信类
 - 高速类



精密结构件

- ▶ **精密冲压件**
 - 弹片系列
 - 屏蔽件
 - 喇叭网
 - 支架类
 - 深拉伸件
- ▶ **精密注塑件**
 - 注塑成型件
 - 金属嵌入式成型件
 - 双色注塑成型
- ▶ **结构组件**



粉末注射成型

- ▶ **转轴模组MIM件**
 - 转轴MIM零件
 - 转轴组件
- ▶ **智能穿戴MIM件**
 - 表壳
 - 表扣
- ▶ **复杂精密结构件**
 - 游戏机手柄结构件
 - 摄像头装饰件
 - 摄像头支架
 - Type C接口
 - 按键
 - 齿轮
 - 陶瓷件



声学

- ▶ **手机扬声器**
 - 客制化
 - 轻薄 Slim
 - 橡胶膜
 - 双驱动
- ▶ **平板/笔电扬声器**
 - 多音圈
 - 双驱动
- ▶ **可穿戴设备扬声器**
 - 5ATM 防水
 - 异形 Slim
 - 大振幅 TWS Driver
- ▶ **智能家居扬声器**
 - 圆形锥盆喇叭

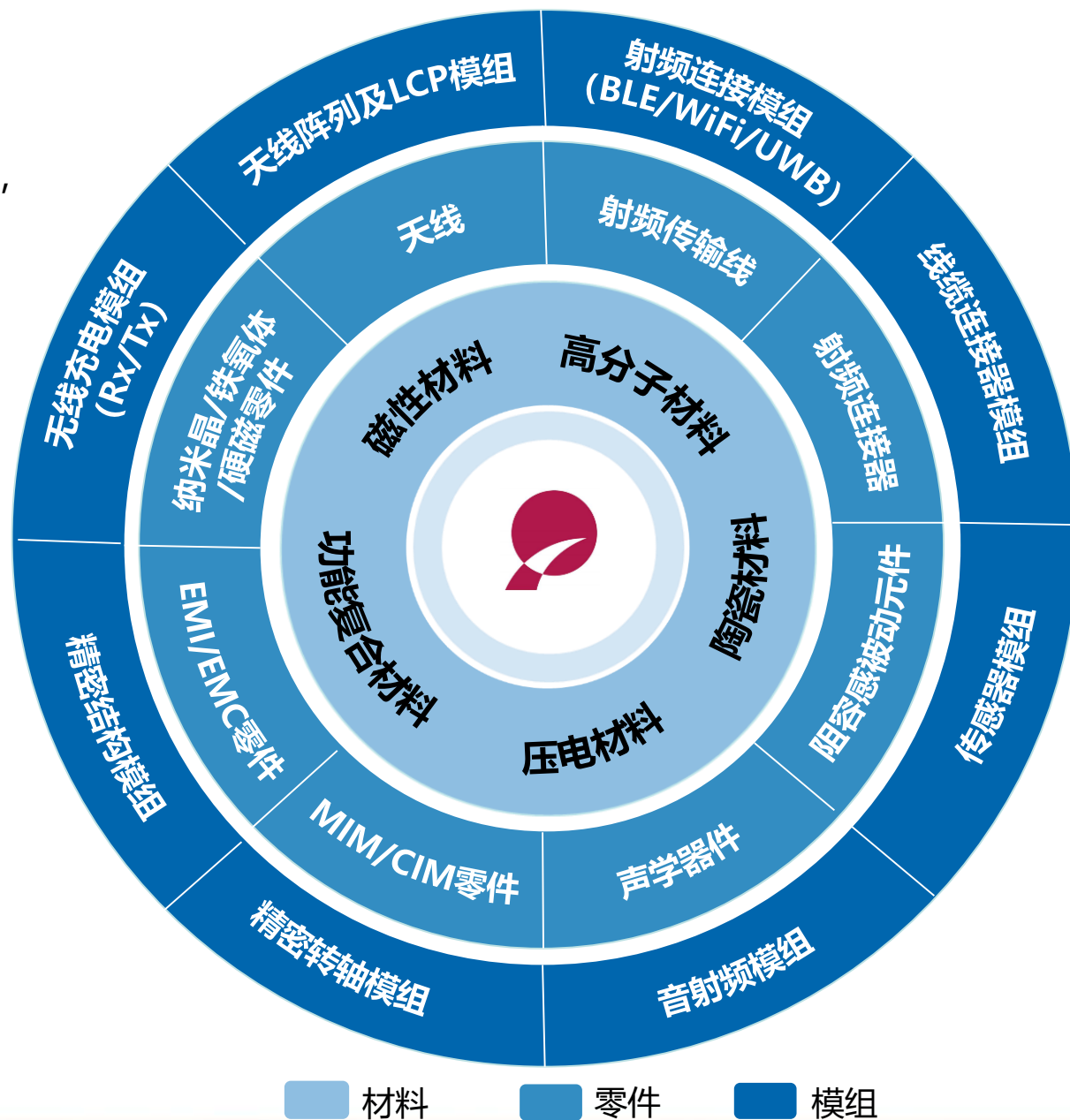


信维使命

致力于通过对**基础材料, 基础技术**的研究, 创造出值得信赖的创新产品与解决方案, 为我们的客户创造价值。

核心竞争力

- 技术驱动
- 垂直整合
- 以材料为基础, 从零件到模组, 为客户提供一站式解决方案



射频连接解决方案

无线充电解决方案

高速互联解决方案

精密结构解决方案

无源器件解决方案

声学解决方案

天线

- 移动终端天线
- 穿戴类天线
- 物联网设备天线
- 5G基站天线
- 汽车天线
- 卫星通信天线

射频传输线

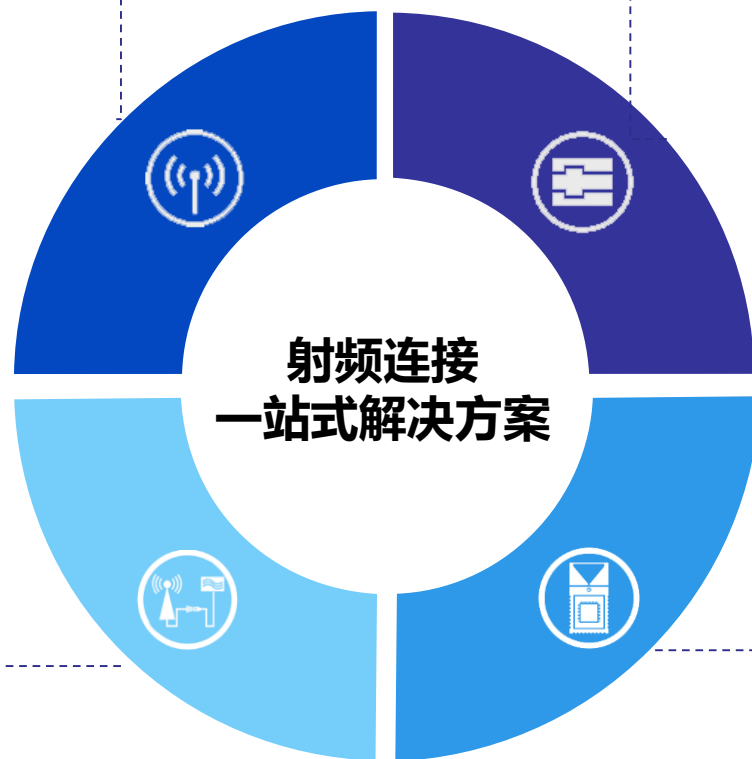
- LCP传输线
- 射频同轴线缆

射频连接器

- 射频BTB连接器
- 射频连接弹片

射频连接模组

- UWB模组
- 毫米波模组
- WiFi/BLE模组





磁性材料

- 软磁 (纳米晶材料、非晶材料)
- 铁氧体片&3D铁氧体
- 永磁材料

设计及仿真

- 系统设计及仿真
- 线圈设计及仿真
- EMC 设计与仿真

垂直整合

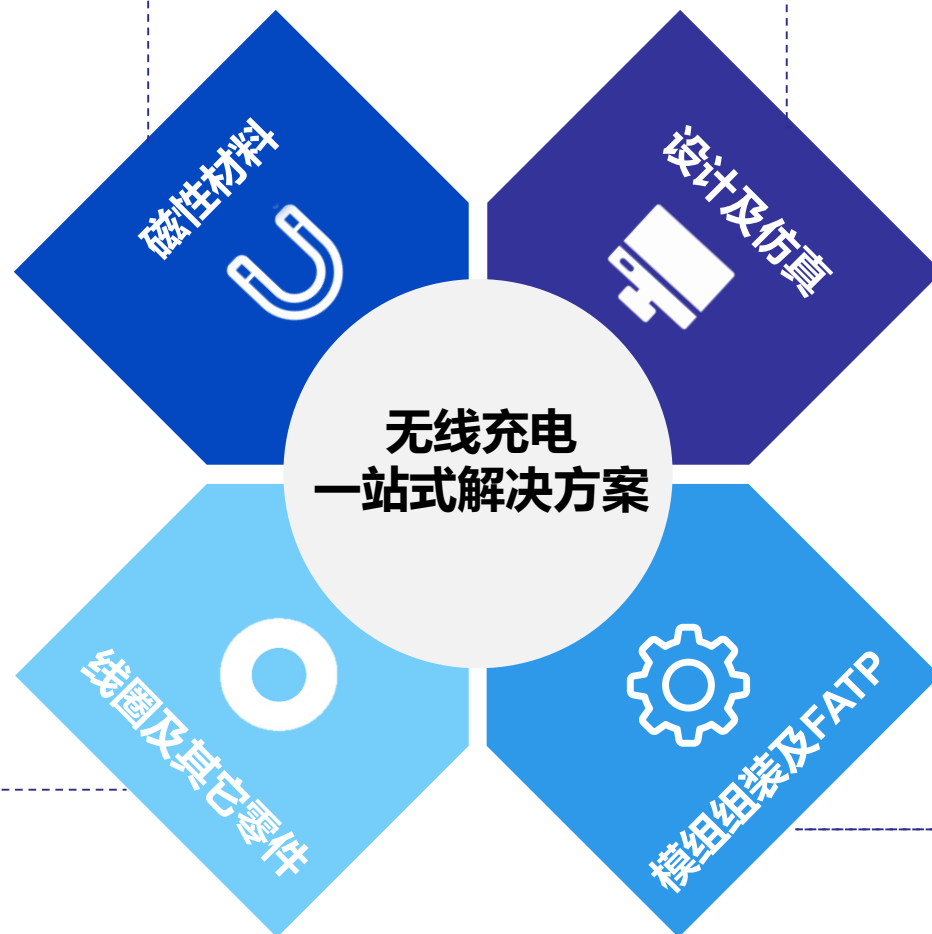
- 线圈
- 精密冲压
- 精密注塑
- 精密模切
- SMT/PCBA
- 自动点胶/焊接
- 线缆组装

模组组装

- Rx & Tx 模组
- 线圈 & 磁性材料组装
- NFC天线组装

FATP能力

- 夹具与生产工艺开发
- 系统测试与分析
- 可靠性测试与分析
- FA分析能力
- 半自动及全自动组装能力



消费类产品连接器

- 板对板连接器
- 射频连接器
- I/O连接器
- 定制化连接器
- 线对板连接器

汽车连接器

- Fakra
- HSD
- H-MTD
- 排针/排母

高速连接器

- 高速传输连接器
- 通信传输连接器

消费类线缆

- 射频线缆
- 测试线缆
- MFi线缆及配件

汽车类线缆

- 汽车充电线缆
- 汽车内部线缆

高速类线缆

- 高速传输线缆
- 通信传输线缆



精密注塑

- 注塑成型
- 金属嵌入式成型
- 双色注塑成型

粉末注射成型(MIM/CIM)

- 转轴模组MIM件
- 智能穿戴MIM件
- 复杂精密结构件

压铸

- 支架
- 底座
- 壳体
- 配重块

精密冲压

- 喇叭网
- 屏蔽罩
- 屏蔽框
- 深拉伸金属件
- 复杂金属焊接件
- 定制化弹片

表面处理

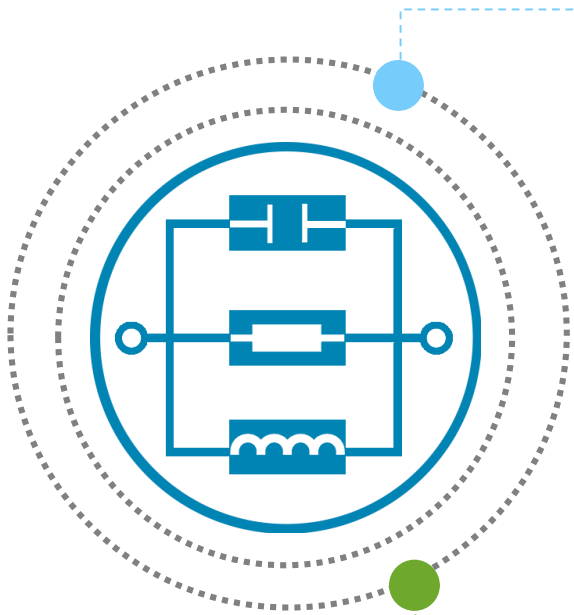
- 电镀
- 喷涂
- PVD

液态硅胶注塑

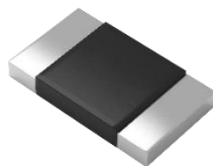
- 消费电子类
- 医疗类
- 汽车类



无源器件一站式解决方案



贴片电阻
(Chip-R)



通用 SC系列

车规 SA系列

抗硫化 SF系列

抗浪涌 SR系列

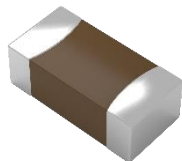
耐高压 SV系列

耐高温 SE系列

排阻 SY系列

合金 SP系列

多层陶瓷电容器
(MLCC)



高容 MH系列

车规 MA系列

通用 MC系列

高频 MQ系列

高压 MV系列

软端子 MS系列

三端子系列

手机类

- 客制化大功率动圈扬声器
- 轻薄化 Slim 解决方案
- 橡胶模 Sonorous 解决方案
- 双驱动 DualAir 平台 (私密通话)

平板/笔电类

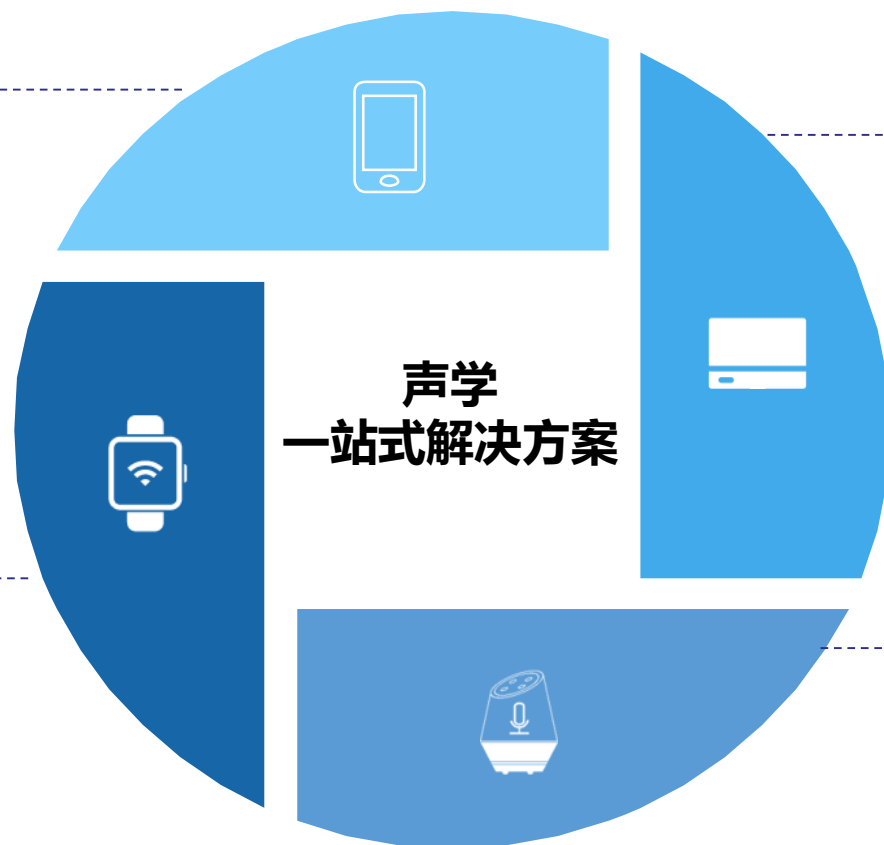
- 客制化大功率动圈扬声器
- 多音圈 Thunderous 解决方案
- 双驱动 DualAir 解决方案 (减震)

可穿戴设备类

- 5ATM 防水 Speaker
- 异形 Slim Speaker XR 解决方案
- 大振幅 TWS Driver

智能家居类

- Outdoor Speaker (IPX8)
- 圆形/椭圆形锥盆平盆喇叭





天线系列

- 蜂窝天线
- GPS天线
- Wi-Fi/BT天线
- NFC天线
- UWB天线

射频连接模组

- UWB模组

无线充电

- 接收端模组
- 发射端模组
- NFC/Qi Rx Combo

无源器件

- 贴片电阻
- MLCC

射频传输线

- LCP射频传输线
- 射频同轴线缆

金属/陶瓷粉末注射成型

- 转轴模组MIM件
- 复杂精密结构件

精密结构件

- 冲压件
- 注塑件
- 复杂焊接件

音射频模组

- 扬声器
- 受话器
- Speaker Box
- 音射频模组

精密连接器

- 板对板连接器
- I/O连接器
- 接触类弹片



车载天线

- 4G/5G蜂窝天线
- WIFI/BLE/NFC/UWB天线
- AM/FM/DAB天线
- 卫星定位天线(GPS/BD/GNSS)
- 车联网天线(V2X)



3D-MID

- 传感器电路
- 车外灯电路
- 车内灯电路
- ADAS和AD传感器



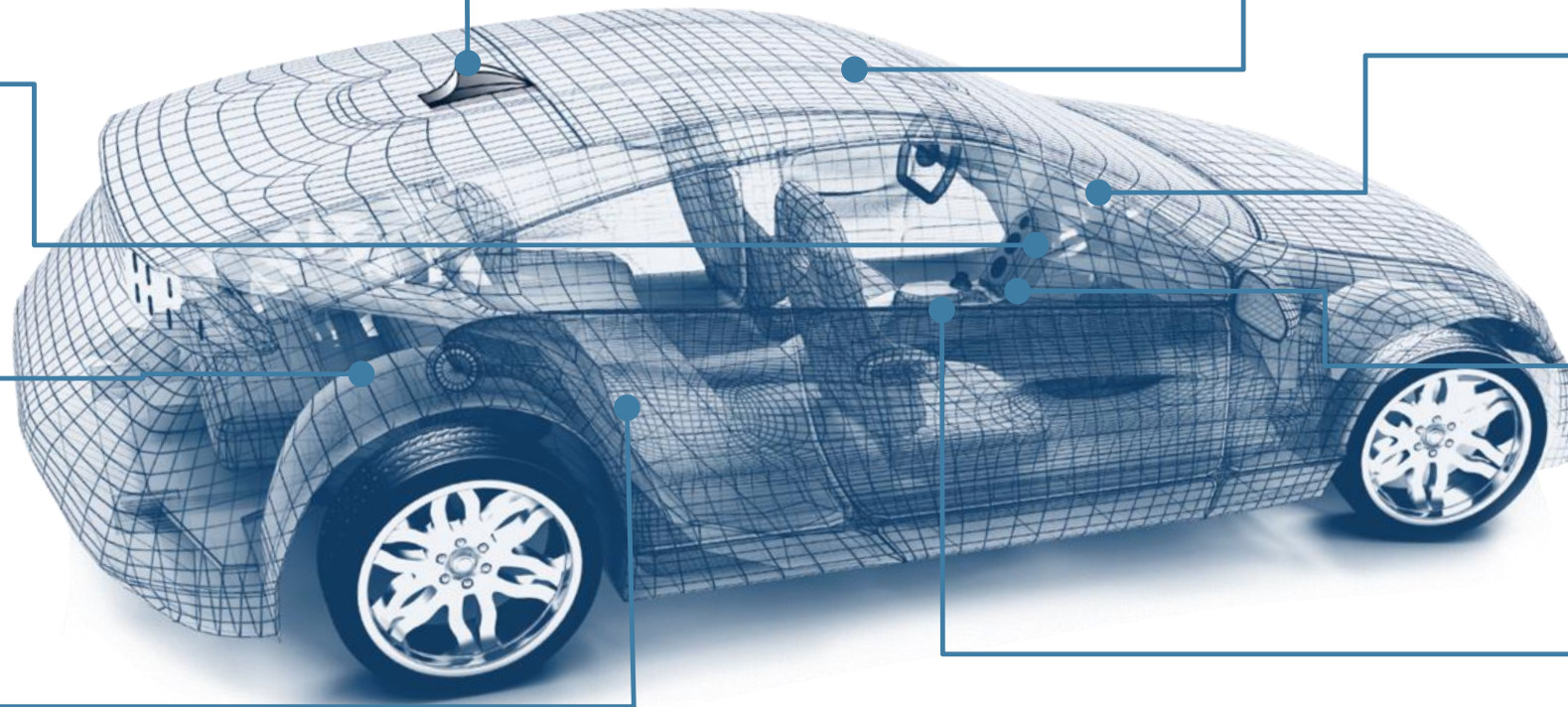
汽车连接器

- Fakra
- H-MTD
- HSD
- 排针/排母



汽车高速线缆

- 定制化线束



UWB模组

- 无钥匙进入系统
- 模组/天线/钥匙/Tag
- 内置雷达模组



无源器件

- 贴片电阻
- MLCC



结构件

- 冲压屏蔽件
- 注塑件
- MIM/CIM
- 接触类弹片



车载充电

- 无线充电器
- 无线充电模组
- 有线快充 (Type C)

应用场景

-  智能音箱
-  楼宇控制系统
-  追踪器
-  视频娱乐系统
-  监控器
-  智能锁
-  白色家电
-  智慧厨房



信维产品

-  **天线系列**
蜂窝, Wi-Fi/BT, NFC, UWB天线
-  **无线充电**
接收端模组, 发射端模组
-  **精密五金**
支架, 屏蔽罩, 金属粉末注射成型
-  **射频连接模组**
UWB模组
-  **精密连接器**
接触类弹片, 板对板连接器, I/O连接器, 射频同轴电缆
-  **机电一体化器件**
塑胶互连电路 (3D MID)
-  **无源器件**
贴片电阻, MLCC
-  **声学组件**
微型扬声器

应用场景



宏基站



小基站



卫星基站接收端



CPE



数据中心



信维产品



天线系列

Sub-6天线, 毫米波天线



机电一体化器件

塑胶互连电路 (3D MID)



精密五金

屏蔽罩, 弹片类



高频高速线缆

信维以技术创新为核心，不断投入前沿研发，确保集团未来的持续增长。

中央研究院

- **天线技术:** LCP天线、Sub6 MIMO天线、毫米波天线、6G天线等
- **基础材料:** LCP/MPI/MPF材料、陶瓷材料、磁性材料、功能复合材料等
- **新型产品:** LTCC、毫米波模组、UWB模组、射频板对板等
- **新型工艺:** 精细电路制造、表面离子金属化、3D-MID等

院所合作

- 绵阳北斗
- 中科院化学所

产学合作

- 美国密苏里大学
- 瑞典皇家理工学院
- 南京大学、东南大学、北京科技大学、武汉理工大学、华南理工大学、深圳大学等

2023年研发投入占营收比例

8.96%

中国5G天线认证专利数量排行



全球5G天线认证专利数量排行



数据来源: 法国研究机构Yole



信维参与了多项全球技术和行业联盟

美国无线通信和互联网协会 (CTIA)



机电一体化研究协会 (3-D MID)



国际无线产业联盟 (IWPC)



无线充电联盟 (WPC)



FiRa协会 (UWB)

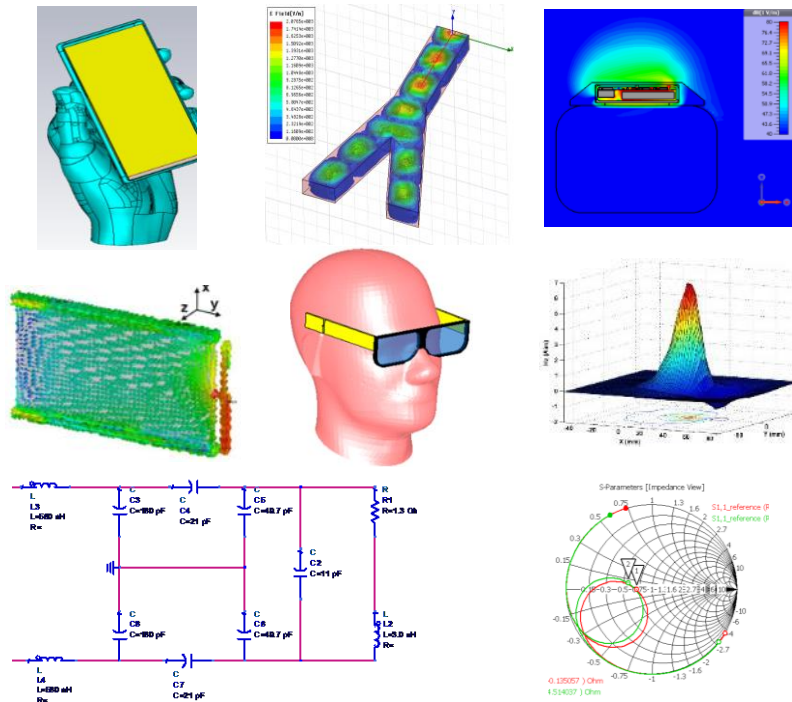


汽车连接协会 (CCC)



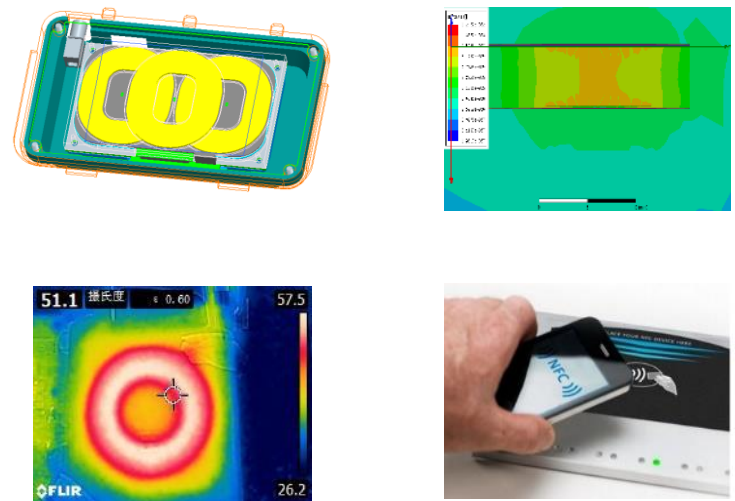
射频仿真 天线、模组

- 远场/近场仿真
- 磁场仿真
- 电流及阻抗分析/仿真
- 电路仿真
- EMI屏蔽效能仿真



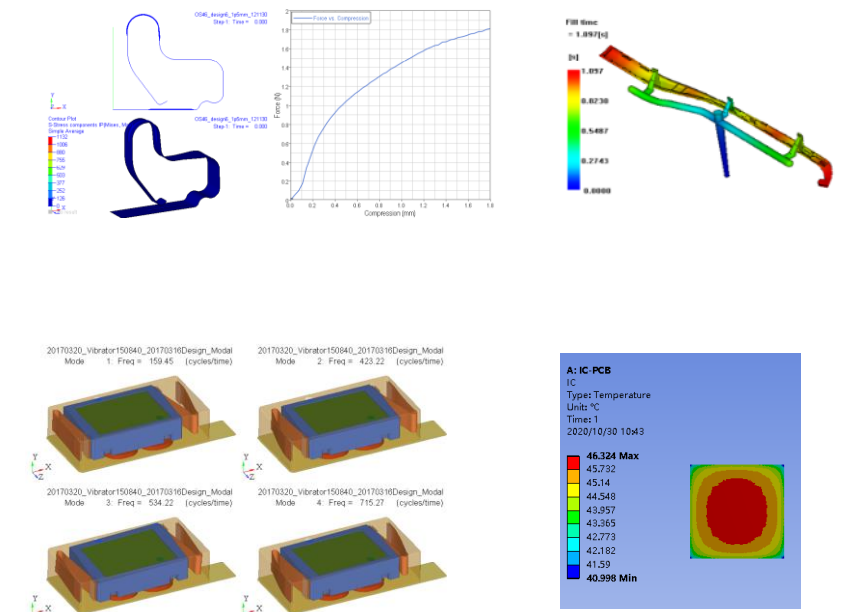
无线充电仿真 接收端、发射端

- WPC线圈设计及仿真
- EMI&EMC解决方案
- 动态线圈参量测定
- 磁性材料设计
- 电路设计和仿真
- 热仿真
- 软件设计



机械结构仿真 材料及结构特性

- 介电仿真、磁场仿真、电导率仿真
- 耐用性、环境可靠性
- 橡胶、金属、超材料仿真
- 热仿真





5G毫米波天线
技术工程实验室



LCP 5G射频系统
工程技术研究中心

由权威机构 (CNAS、CTIA以及SIEMIC) 认证通过的射频实验室,

- 2017年被认定为**深圳市5G毫米波天线技术工程实验室**
- 2018年被广东省科学技术厅认定为**广东省LCP 5G射频系统工程技术研究中心**



5G毫米波 OTA暗室



5G Sub6 OTA暗室



MIMO OTA 暗室



SISO OTA 实验室



电磁兼容实验室



射频实验室



可靠性实验室



SAR实验室



材料	模具开发	产品工艺	组装及测试
高分子材料 (LCP/MPI) 陶瓷材料 (天线/阻容) 磁性材料 (软磁/硬磁)	冲压模具 注塑模具 MIM模具	金属冲压 精密注塑 粉末注射成型(MIM/CIM) 3D-MID 表面处理(电镀/化镀/PVD) 磁性材料加工 模切 表面贴装(SMT) CNC 压铸	天线 射频模组 无线充电模组(Rx/Tx) 精密结构件 精密连接器 射频同轴线缆 LCP模组 弹片 线缆组装 无源器件 扬声器/受话器/声学模组



模具加工中心



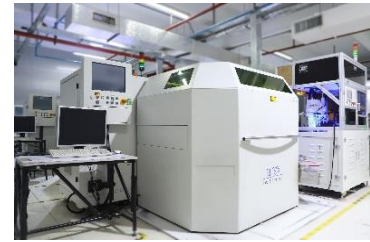
冲压机



注塑成型机



电镀线



3D镭雕机



粉末注射成型



表面贴装



天线生产线



无线充电生产线



软板SMT自动化



板对板连接器生产线



接触类弹片自动包装线

核心能力:

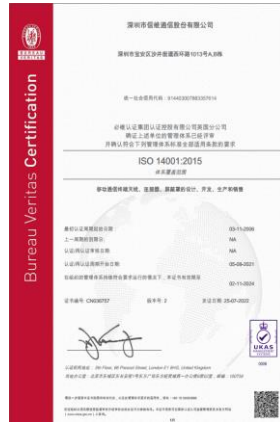
- 公司层面统一的自动化专业团队
- 500余位经验丰富的机构/电控/软件自动化工程师团队
- 具备快速成型能力
- 具备自主夹、治具设计制造能力
- 具备为大批量产品设计全自动生产线的的能力
- 专注于射频类测试夹具与自动化设备的开发



无源器件生产线



ISO9001



ISO14001



QC080000



ISO/IEC17025



IATF16949



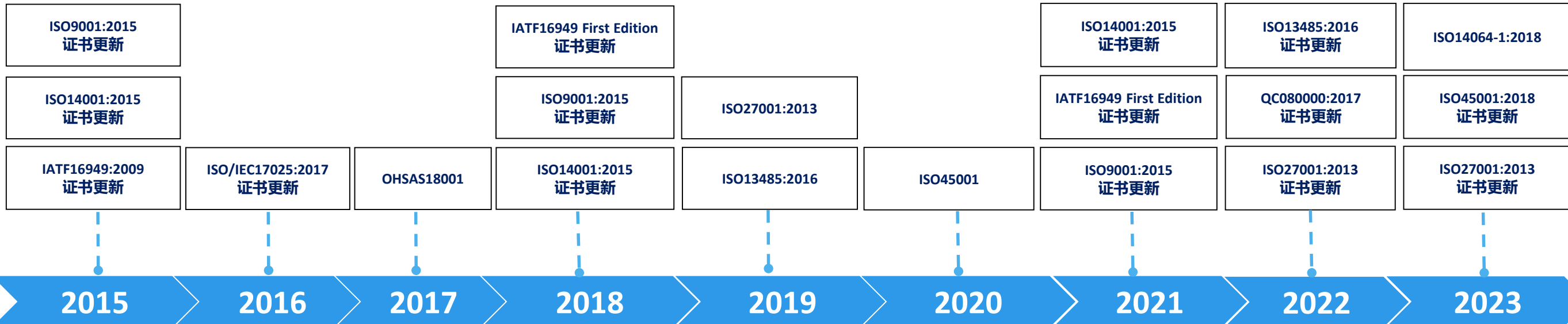
ISO45001



ISO27001



ISO 13485





信维公益基金会

帮助困境中的行善者/被遗忘的奉献者，
支持困境中的强者



中国清洁能源基金

信维通信已参与投资由Apple发起的
“中国清洁能源基金”



光伏发电能源计划

信维通信11MW分布式光伏发电项目正式
投运发电，公司积极响应“节能减排”号
召，用心践行“绿色低碳”理念



冲突矿产方针

信维通信承诺只从经过独立第三方验
证的冶炼厂/精炼厂采购





本分



客户满意



结果导向



追求极致



勇于担当



快步小跑的企业文化



The End